

助焊膏

◆ 产品描述

助焊膏采用高品质配方，焊接流动性好，润湿性能优异，无残留易清理，适配精密电子焊接，提升焊接质量与效率。

◆ 产品优势

- 流动性好
- 润湿力强
- 无残留
- 易清理
- 焊接高效

◆ 产品结构

均匀膏状质地，细腻无颗粒，稳定化学配方，密封罐装设计，防氧化包装，便于精准取用

◆ 应用场景

电路板焊接、电子元器件组装、精密仪器焊接、手机维修焊接、家电生产焊接工艺

◆ 产品特性

固含量≥85%
焊接温度 183-230°C
粘度 80-120Pa·s
保质期 6 个月（冷藏）
不含卤素
润湿时间≤3 秒

物料编码	重量	包装方式
1.5.19.03.0038	0.14kg	独立包装

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有

